

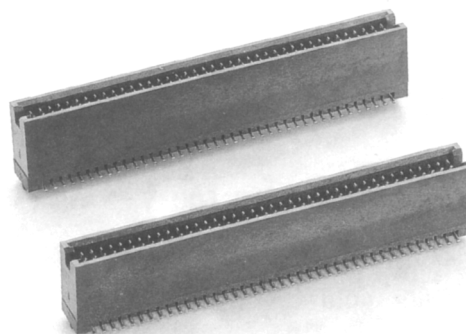
# 6111

## SMT Wannenstiftleisten - Board to Board - RM 1,27 x 1,27 mm

SMT Box Header - Board to Board - Pitch 1,27 x 1,27mm

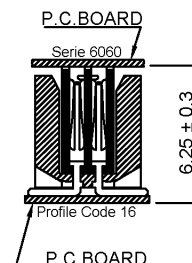
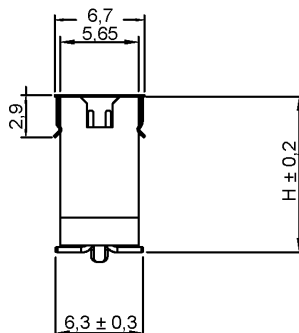
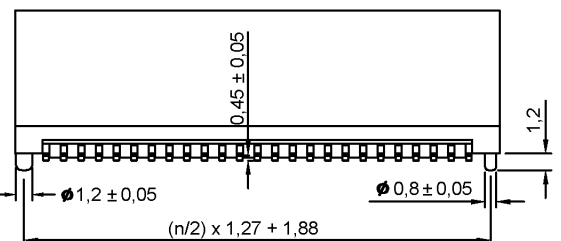
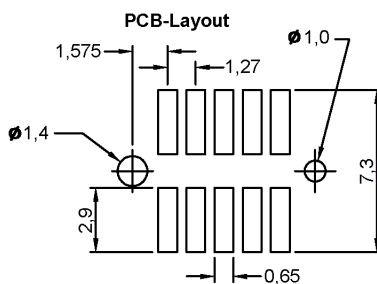
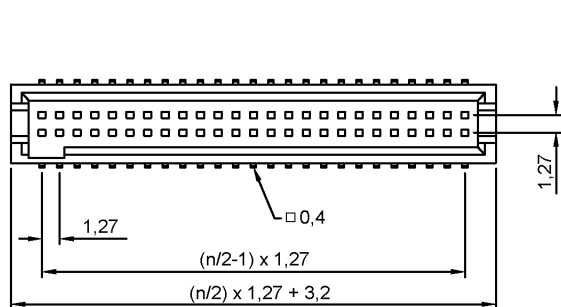
### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Vierkantstift □ 0,40 mm, CuZn 30
Contact Material	Square Pin □ 0,40 mm, CuZn 30
Kontaktfläche	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm)
Contact Surface	acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 5x10 <sup>9</sup> Ohm
Insulation Resistance	> 5x10 <sup>9</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit	500 V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500 V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40°C...+105°C
Temperature Range	-40°C...+105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serie:  
Mates with Female Headers Series:  
6060 ( mit Bauhöhe 4,6 mm /  
with Height 4,6 mm )



n = Anzahl der Kontakte  
n = No. of Contacts

Series	Contacts*	Profile* (H)	Plating*	Packing*
6111	100	10	50	PPST
	010-100-pol.	02 = 7,3 03 = 9,5 04 = 9,9 05 = 10,1 06 = 11,2 07 = 11,5 08 = 11,7 09 = 12,0	10 = 12,7 11 = 14,6 12 = 15,7 13 = 16,1 16 = 5,8 17 = 10,9 18 = 6,1 19 = 17,8	00 = vergoldet gold plated 50 = verzinnt tin plated 60 = sel. Au / Sn duplex plating
				00 ST PPST

### Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / bulk good w/o PP-Pad

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes

PPST = in Stangen mit PP-Pad / in tubes w/ PP-Pad

PPTR \*\* = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing w/ PP-Pad  
(\* \*\* auf Anfrage / upon request)

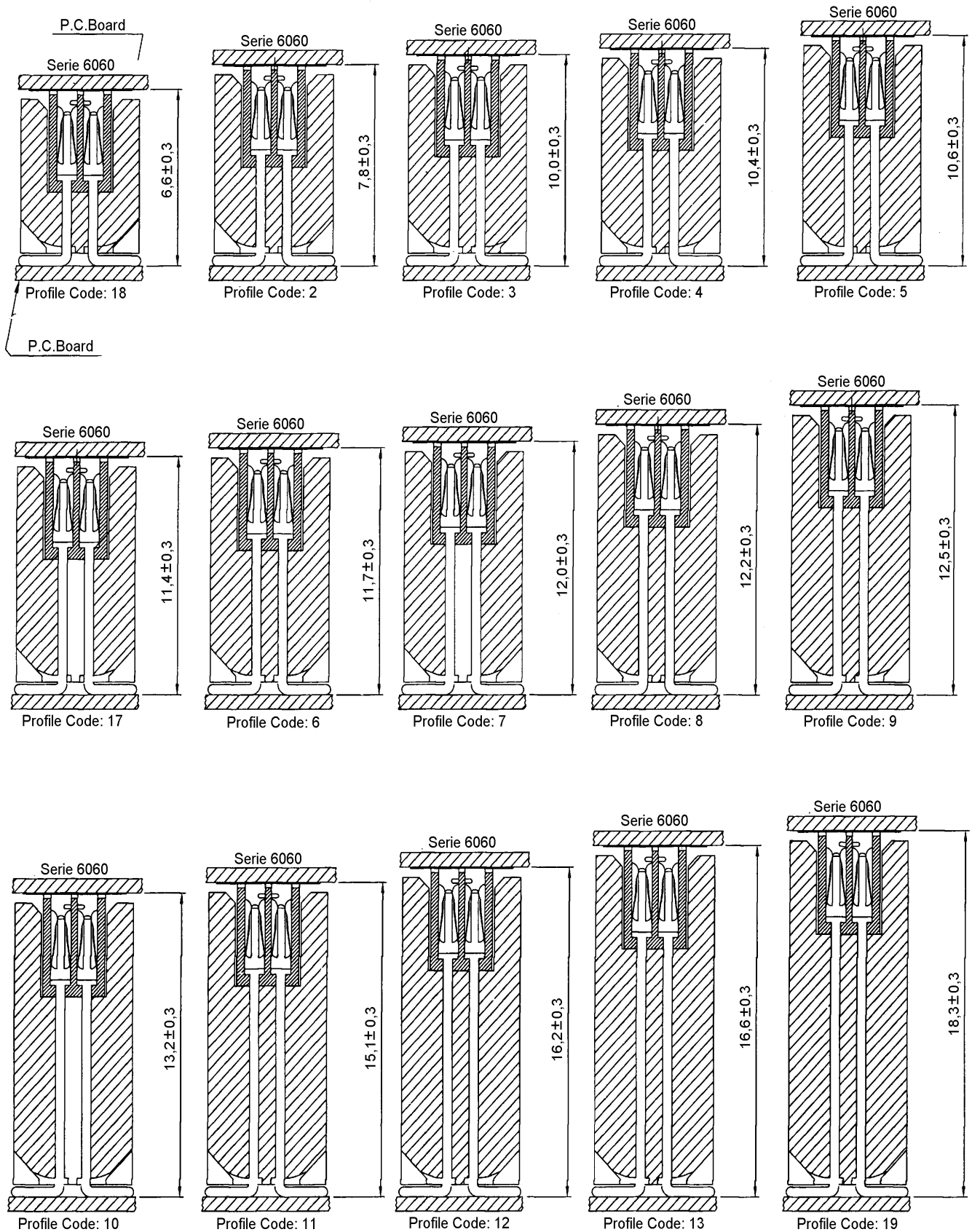
(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX : +49 5223 98507-20

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

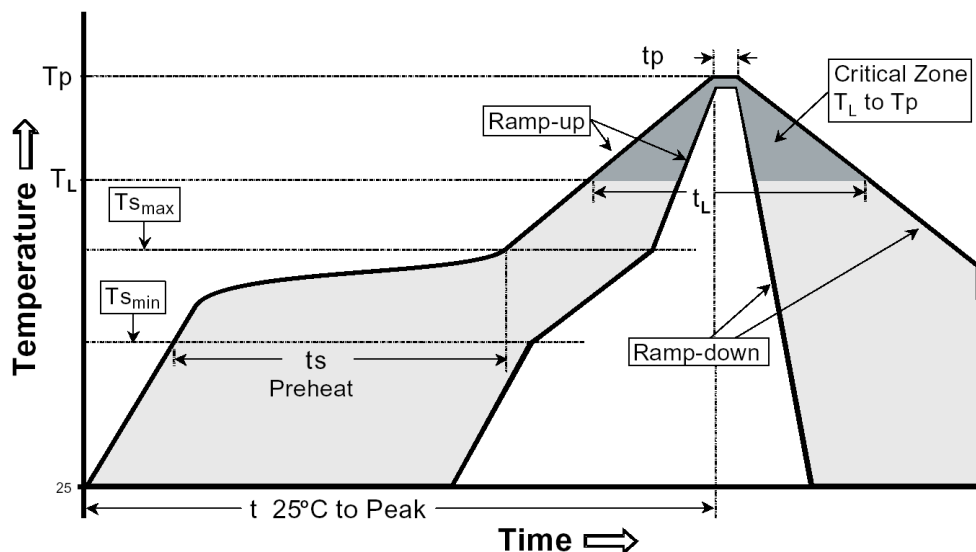
© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T